

有机硅灌封胶
ICM-HG501

技术参数表
TECHNICAL DATA SHEET

一、产品特点及应用 **Characteristic & Application**

- 1, ICM-HG501 是双组份加成型有机硅灌封胶，固化后形成高性能弹性体。
- 2, ICM-HG501 固化后收缩率极低，不会放出热量及副产物。
- 3, 具有优良的电气性能，耐老化、耐高低温，防水防潮，深层固化好。
- 4, 对灌封元器件无腐蚀，对周围环境无污染，符合各类相关环保要求。
- 5, 广泛用于各类电子元器件、LED、各类控制器、传感器、变压器、无人机等产品的灌封填充。
- 6, 耐温范围：-60~250

二、固化前性能 **As supplied**

项目	检测单位/方法	A 组份	B 组份
外 观	目 测	黑色流体	白色流体
粘 度	mpa•s	2500~4000	2000~2500
配 比	重量比	1:1	
密 度	25°C g/cm ³	1.60±0.05	1.60±0.05
AB 剂混合粘度	mpa•s	1800±200	
可操作时间	100g / 25°C	40~50 分钟	
固化时间	hr/°C	初步固化：4~8 小时，可加热 80 度 1~2 小时	

三、固化后性能 **As cured**

项目	单位	数值	检测方法
固化物颜色	—	灰色/黑色/白色	目视
硬度	SHORE A	55±5	GB/T 531.1-2008
介电强度	KV/mm	20~25	GB/T 1693-2007
固化物密度	25°C g/cm ³	1.5±0.05	GB/T 13354-921
体积电阻率	Ω•cm	1.2×10 ¹⁶	GB/T 1692-92
膨胀系数	μm/(m,°C)	210	GB/T20673-2006
导热系数	W/m.k	0.8	ASTM D5470
吸水率	24h/25°C/%	0.01~0.02	GB/T 8810-2005

四、使用工艺及注意事项 How to apply

- 1, 使用前先把 A、B 组分在容器内充分搅拌均匀。
- 2, 应遵守 A 组分: B 组分=1:1 的重量比, 并搅拌均匀。
- 3, AB 胶料混合后应真空排泡 4~6 分钟。
- 4, 胶料放置一段时间后会沉淀, 故在使用前请先将 A、B 组分再次搅拌均匀, 取用后注意密封保存。
- 5, 该产品使用时, 若触及含锡、硫、胺及其他重金属物质, 则会由于“中毒”而难固化或不固化, 使用时应注意清洁, 防止带入杂质。

五、包装规格及贮存运输 Packaging, Storage and Delivery

- 1, 20KG/桶、20KG/桶
- 2, 在 25℃以下本产品的贮存期为 12 个月, 超过保存期限的产品应确认无异常后方可使用。
- 3, 此类产品可按一般化学品运输, 小心在运输过程中泄漏。

六、声明公告 Declaration

- 1, 本文的数据是在各种实验和技术信息为基础而制作的, 由于使用条件的差异, 其使用方法和效果只供参考, 使用者在使用之前要参照这些数据和使用条件进行分析和试验, 确认该产品的特性和效果是否使用。
- 2, 本产品为化学产品, 产品性能与环境 and 工艺以及使用情况相关。故银久洲不担保在特定情况下使用时出现的问题, 并不承担任何直接、间接或意外损失责任。
- 3, 用户在特定情况下的使用过程中遇到任何问题, 请与银久洲技术服务部联系, 我们将会为您提供专业的服务。
- 4, 客户在使用前, 请务必进行必要的试验确认, 使产品适合您的工艺或用途, 产品可靠性取决于我们双方。
- 5, 我们保留对以上数据进行修改的权利。敬请客户使用本产品时, 以实测数据为准。